

证券代码：002579  
债券代码：124004  
债券代码：124005

证券简称：中京电子  
债券简称：中京定转  
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—022

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 关于对全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属各子公司根据 2021 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，担保额度不超过人民币 48 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式。担保额度有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。

3、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

4、该事项已经公司 2021 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，并拟提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、担保额度

单位：万元

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度
1	惠州中京电子科技有限公司	全资子公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	全资子公司	160,000
3	珠海元盛电子科技股份有限公司	全资子公司	60,000
4	珠海中京半导体科技有限公司	全资子公司	30,000
5	惠州中京智能科技有限公司	全资子公司	20,000
6	香港中京电子科技有限公司	全资子公司	10,000
合计			480,000

### 三、子公司基本情况

#### 1、惠州中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：2.8亿人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：印制电路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

截至2019年12月31日，资产总额172,728.02万元，净资产总额65,261.44万元，资产负债率62.22%，营业收入144,145.36万元，净利润14,230.53万元，上述财务数据经审计。

截至2020年9月30日，总资产202,554.78万元，净资产64,249.60万元，资产负债率68.28%，营业收入110,693.43万元，净利润8,939.93万元，上述财务数据未审计。

#### 2、珠海中京电子电路有限公司

注册地址：珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室

注册资本：3亿元人民币

与上市公司关系：全资子公司

法定代表人：刘德威

经营范围：印制电路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务；货物进出口。

最近一年又一期主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 12,923.85 万元，净资产 9,994.17 万元，资产负债率 22.67%，营业收入 0.00 元，净利润-5.33 万元，上述财务数据经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 38,987.30 万元，净资产 10,392.46 万元，资产负债率 73.34%，营业收入 0.00 万元，净利润 398.30 万元，上述财务数据未审计。

### 3、珠海元盛电子科技股份有限公司

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本：7030 万元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性电路板、多层柔性电路板、刚柔结合电路板、封装载板。

最近一年又一期主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 82,152.36 万元，净资产 38,356.29 万元，资产负债率 53.31%，营业收入 64,987.32 万元，净利润 4,180.59 万元，上述财务数据经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 88,112.38 万元，净资产 43,428.84 万元，资产负债率 50.71%，营业收入 53,119.06 万元，净利润 5,037.70 万元，上述财务数据未审计。

### 4、惠州中京智能科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售电子元器件与电子终端设备；医疗卫生机构的投资与经营；接受医疗卫生机构委托从事管理与咨询；医疗器械、医疗智能终端及医疗相关药品、试剂与耗材的投资与经营；医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务；医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；产业园开发建设；创业孵化器经营管理；物业租赁；物业管理；停车场管理；会议服务；酒店管理；餐饮管理；实业投资。

最近一年又一期主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11,931.98 万元，净资产 9,672.78 万元，资产负债率 18.93%，营业收入 0.00 元，净利润-2,04.64 万元，上述财务数据经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 16,768.02 万元，净资产 9,512.85 万元，资产负债率 43.27%，营业收入 0.00 元，净利润-159.93 万元，上述财务数据未审计。

##### 5、香港中京电子科技有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：10,000 元港币

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：进出口贸易

最近一年又一期主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 17,709.62 万元，净资产 817.95 万元，资产负债率 95.38%，营业收入 35,775.17 万元，净利润-90.60 万元，上述财务数据经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 16,422.37 万元，净资产 962.67 万元，资产负债率 94.14%，营业收入 24,641.07 元，净利润 161.86 万元，上述财务数据未审计。

#### 6、珠海中京半导体科技有限公司

注册地址：珠海市高栏港经济技术开发区

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：杨林

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售 IC 载板、集成电路封装载板、半导体测试板、类载板、高多层柔性电路板、高密度互联刚柔结合板；半导体集成电路封装测试；半导体器件、光电子器件、电子系统模块模组封装与制造；新型电子元器件与半导体集成电路产业项目投资。

珠海中京半导体科技有限公司成立于 2020 年 6 月。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 100.06 万元，净资产 100.04 万元，资产负债率 0.01%，营业收入 0.00 元，净利润 0.043 万元，上述财务数据未审计。

#### 四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期：自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止

#### 五、董事会意见：

董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

#### 六、独立董事意见

经审查，我们认为：公司对子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了

解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司实际担保余额为 134,097.99 万元（占 2019 年度经审计净资产的 127.27%，占最近一期净资产的 51.23%，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

#### 八、备案文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日